
南亞電路板股份有限公司
2021年第三季營運結果法說會

2021年11月11日



免責聲明

歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前南亞電路板股份有限公司之財務狀況或營運結果。

本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與本會明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。

除主管機關要求公開之資訊外，本公司並無義務揭露或更新對未來產品方面之意見與看法。



議程

- 公司概況
- 財務狀況
- 產品未來發展方向
- 未來營運目標



公司概況

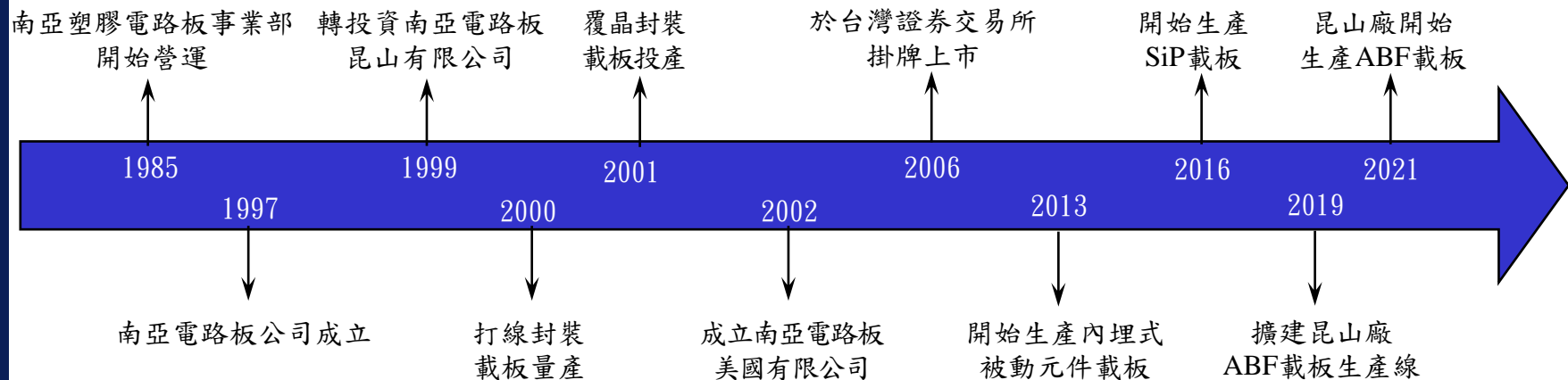
事業簡述

- 南亞塑膠工業股份有限公司之轉投資公司
- 生產與銷售IC載板與一般電路板
- 2021年前三季合併營業額為新台幣374.5億元
- 台股上市市值：新台幣2,810.8億元(2021年9月30日)
- 生產廠區：台灣、大陸



公司概況

歷史沿革

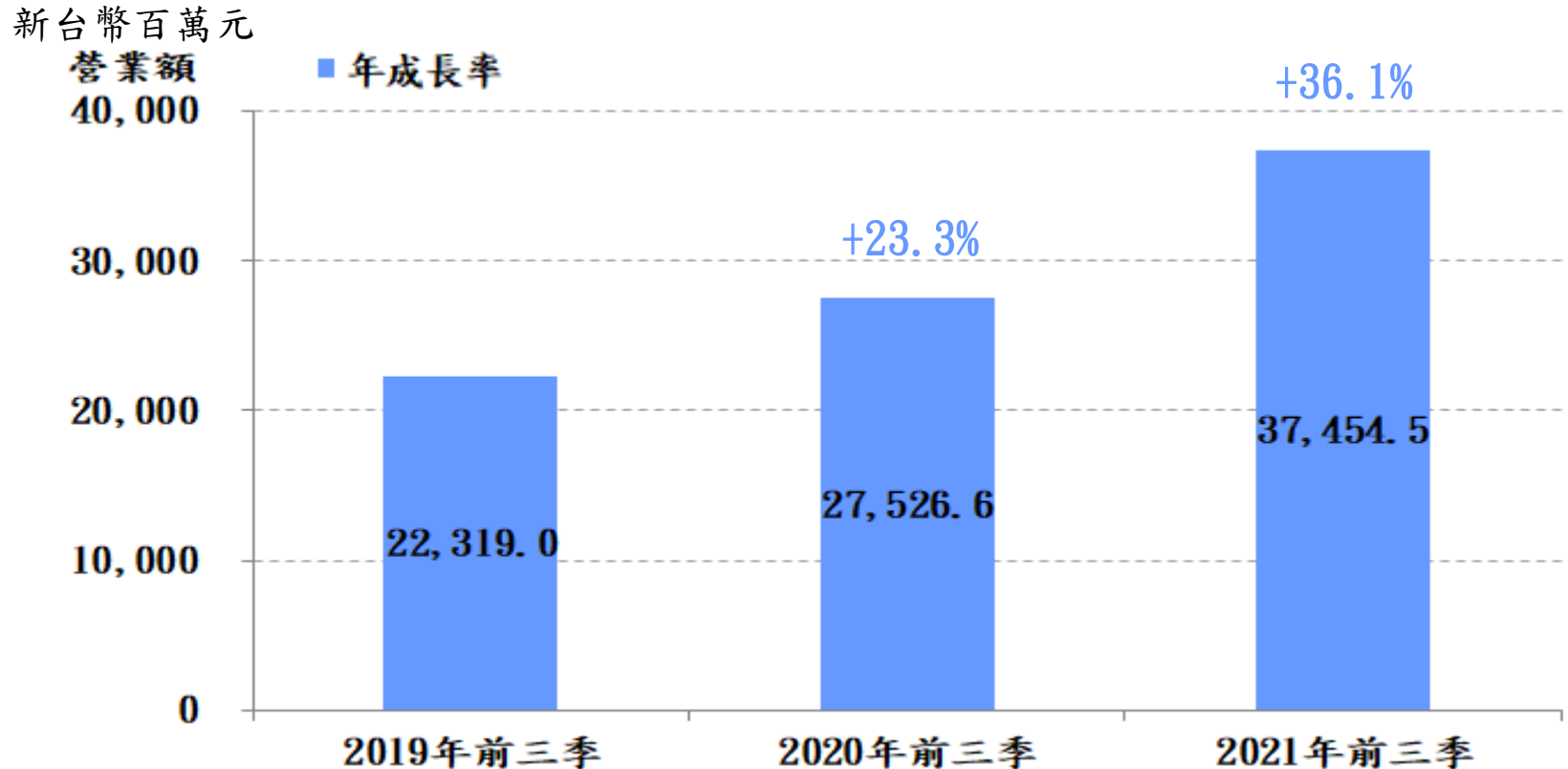


- 1985 : 南亞塑膠公司電路板事業部成立並開始生產一般電路板
- 1997 : 經南亞塑膠董事會通過，以轉投資方式成立南亞電路板公司
- 1999 : 轉投資南亞電路板(昆山)有限公司，註冊資本額2,980萬美元
- 2000 : 進入IC載板領域並量產打線封裝載板
- 2001 : 進行技術升級，開始投產覆晶封裝載板
- 2002 : 成立南亞電路板(美國)有限公司
- 2006 : 正式於台灣證券交易所掛牌上市，交易代號為8046
- 2013 : 產品技術升級，開始生產內埋式被動元件載板
- 2016 : 開始生產系統級封裝載板(System in Package, SiP)
- 2019 : 因應市場需求，開始於昆山廠擴建ABF載板生產線
- 2021 : 昆山廠開始生產ABF載板



財務狀況

近三年前三季合併營業收入(IFRS)

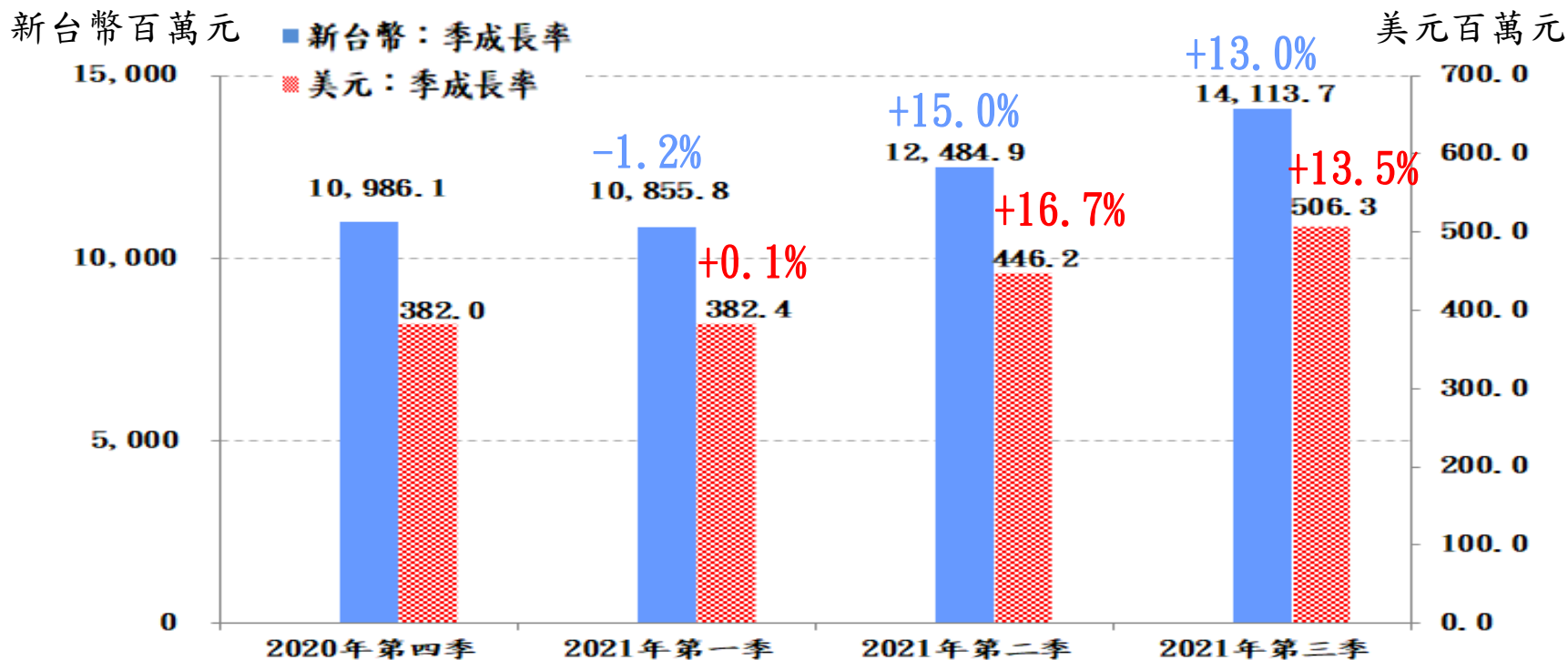


- 2020年前三季營收較2019年前三季增加23.3%:
本公司提早佈局高階網通與系統級封裝載板等 high 價值化產品市場，受益於客戶需求提升，2020年前三季營收比2019年同期顯著成長。
- 2021年前三季營收較2020年前三季增加36.1%:
本公司因高階電腦、網通、人工智慧及高效運算等應用產品銷售增加，IC載板需求續旺，2021年前三季營收比2020年同期再成長。



財務狀況

近一年每季合併營業收入(IFRS)

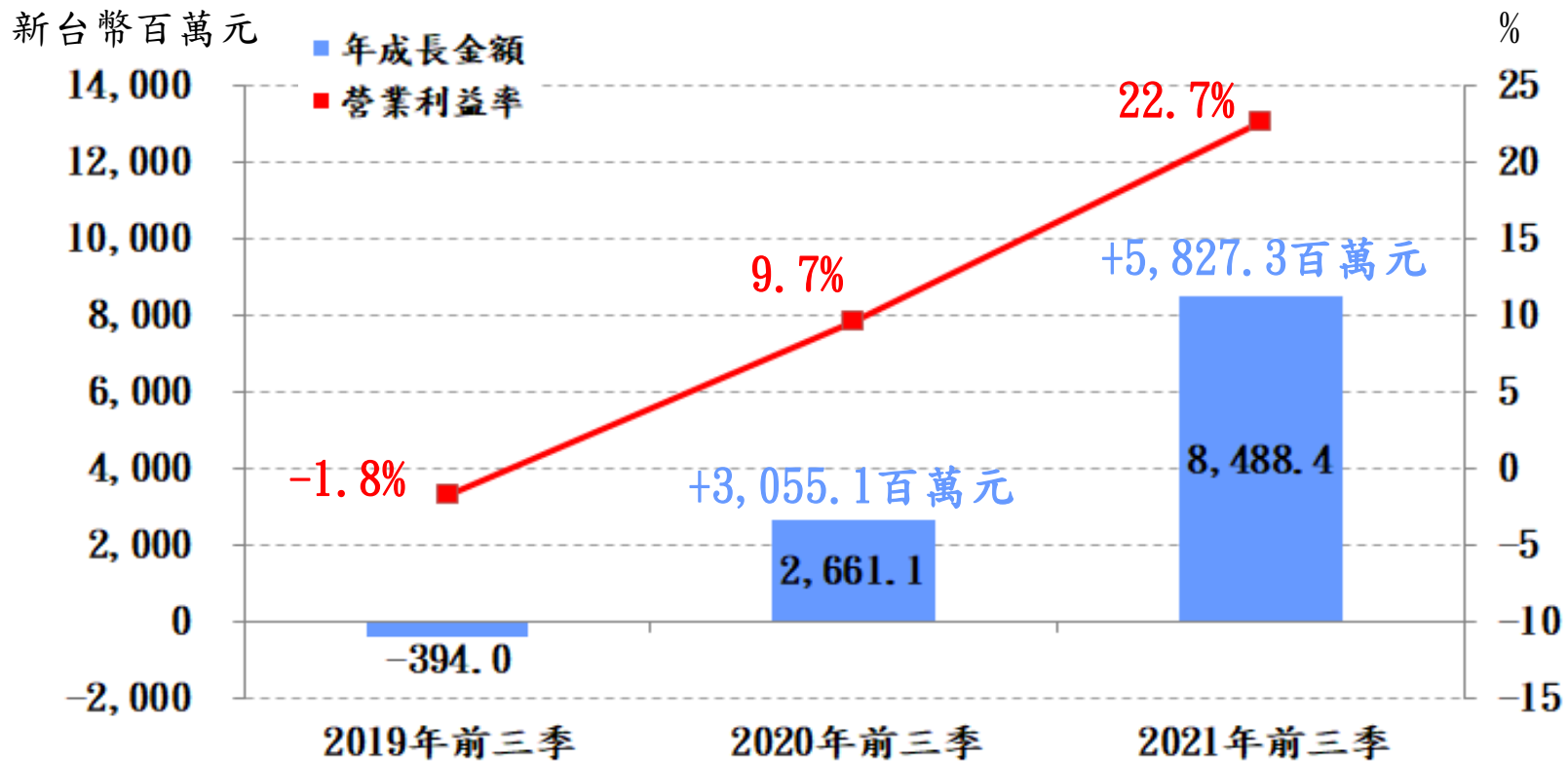


- 2021年第一季營收較2020年第四季減少1.2%：
第一季因工作天數減少，營收比2020年第四季略為下滑；若採原幣美元計算，則為成長0.1%
- 2021年第二季營收較2021年第一季增加15.0%：
第二季因高值化產品銷售增加與IC載板新產能挹注，營收比第一季成長。
- 2021年第三季營收較2021年第二季增加13.0%：
第三季受益於高值化產品比重持續提升與傳統銷售旺季，營收比第二季再成長。



財務狀況

近三年前三季營業利益(虧損)

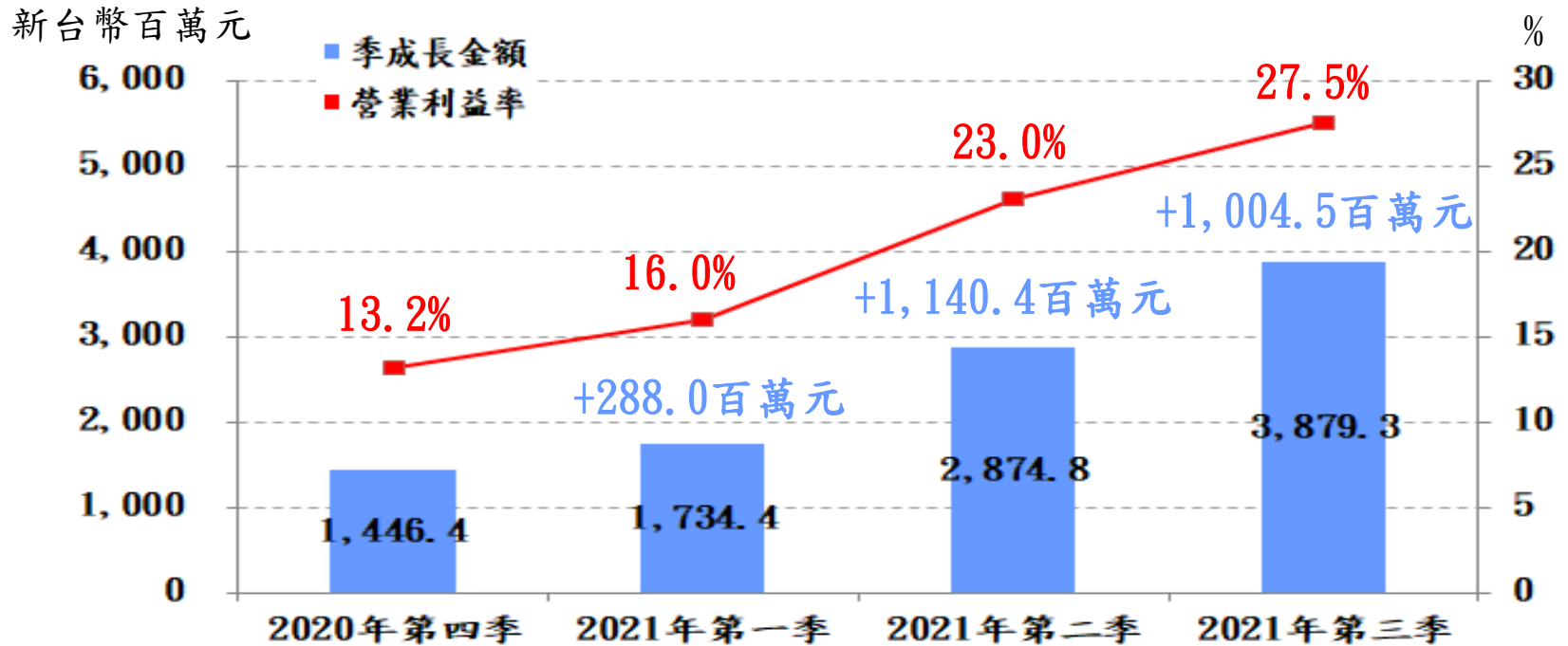


- 2020年前三季營業利益較2019年前三季增加3,055.1百萬元：
本公司2020年前三季持續優化製程，提升良率，且在高階網通產品銷售增加的情況下，前三季營業利益額(率)逐季上升。
- 2021年前三季營業利益較2020年前三季增加5,827.3百萬元：
本公司除高值化產品銷售增加與IC載板新產能貢獻外，也將人工智慧導入生產管理，提升生產良率與效率，致前三季營業利益額(率)持續提升。



財務狀況

近一年每季營業利益

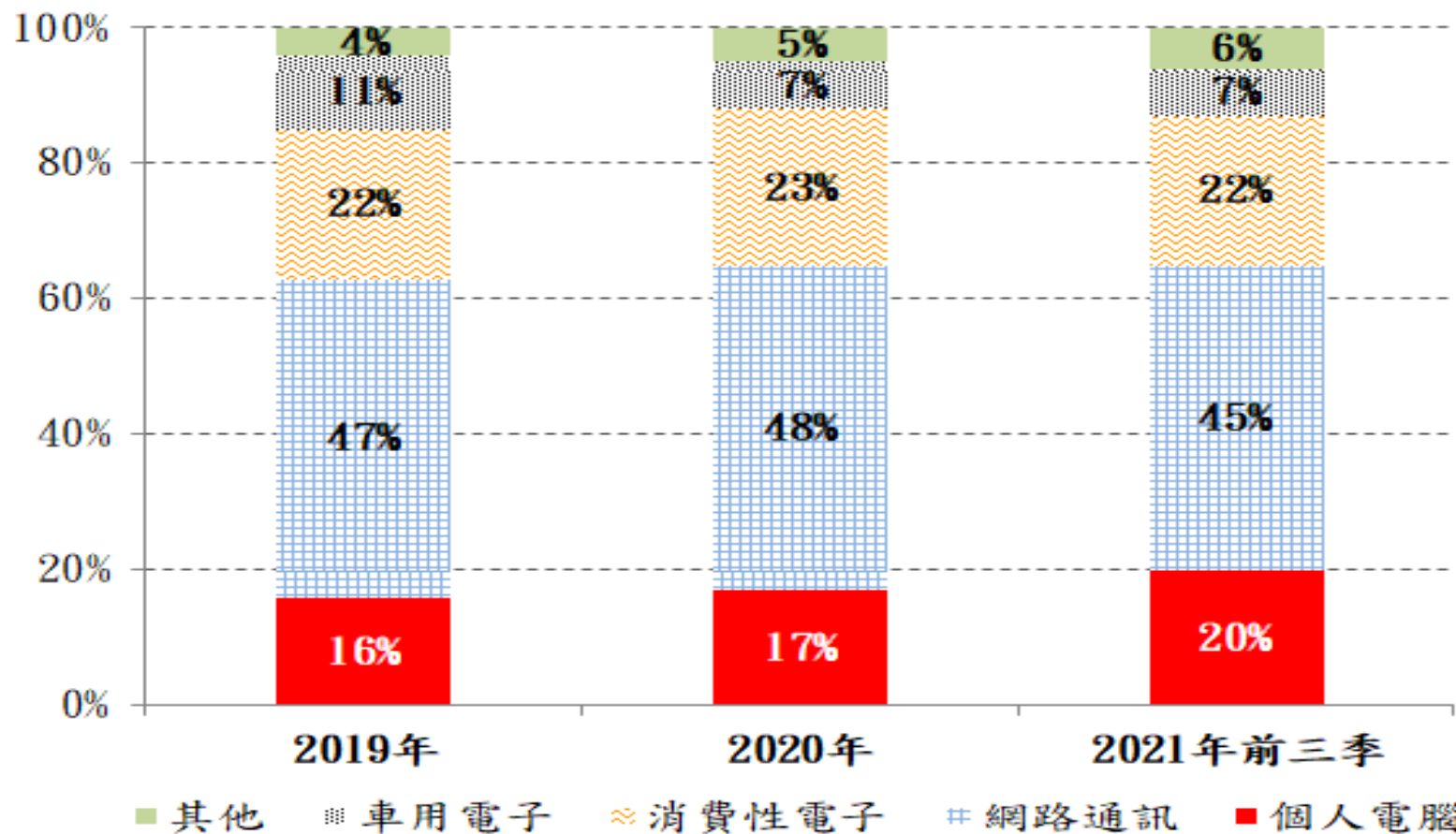


- 2021年第一季營業利益較2020年第四季增加288.0百萬元：
高階電腦處理器、繪圖晶片載板銷售成長，2021年第一季營業利益再提升。
- 2021年第二季營業利益較2021年第一季增加1,140.4百萬元：
因高值化產品銷售成長與IC載板新產能於2021年第二季全能生產，獲利持續提升。
- 2021年第三季營業利益較2021年第二季增加1,004.5百萬元：
因產能利用率提升與高值化產品比重增加，2021年第三季獲利再提升。



財務狀況

營業收入結構(應用別)

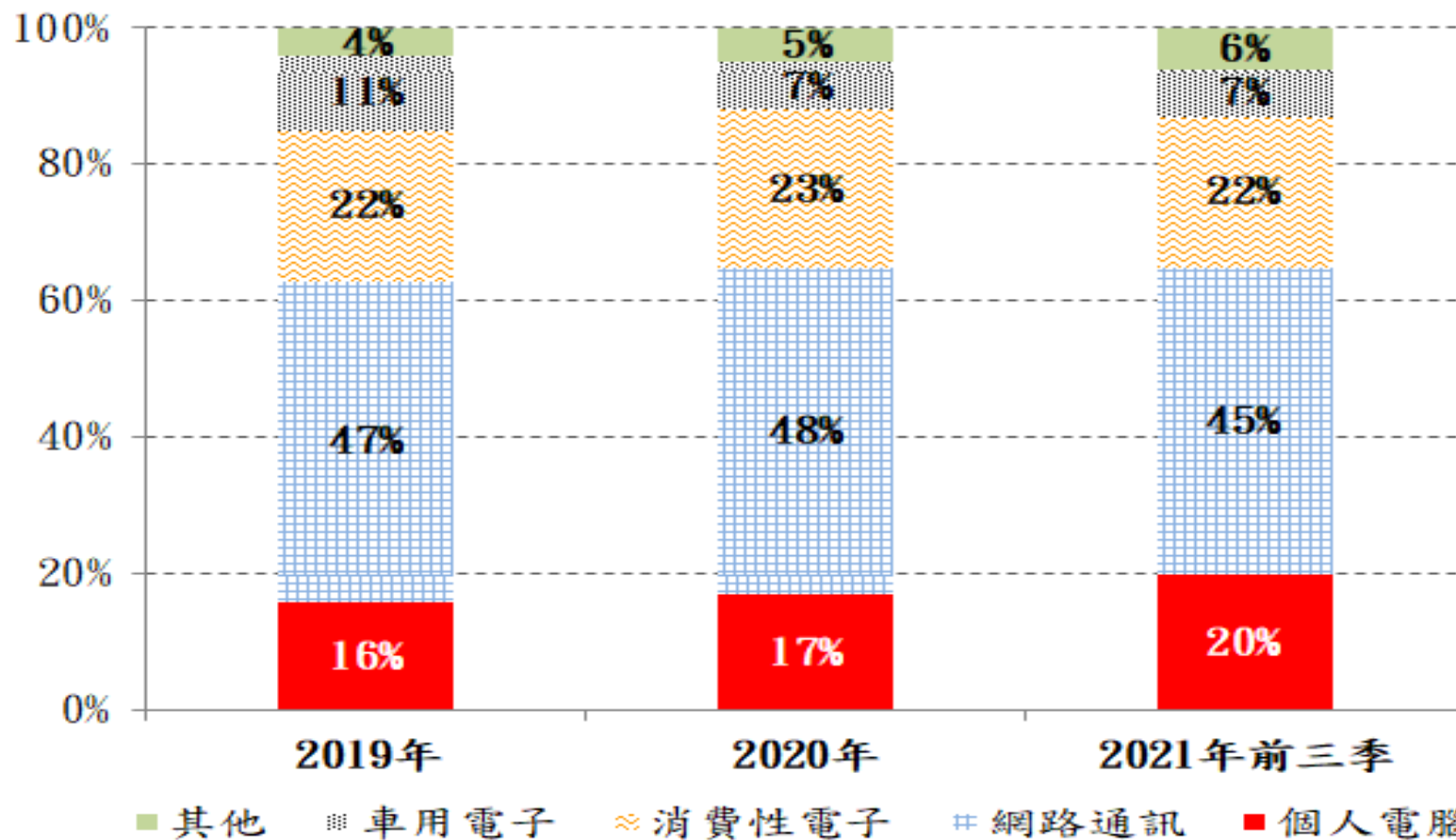


- 本公司個人電腦受益於資料中心、遠距商務及居家娛樂需求增加，2021年前三季電腦營收比重持續提高。
- 因基地台需求受疫情影響與新世代穿戴式裝置尚未推出，2021年前三季網通與消費性電子營收比重下滑。



財務狀況

營業收入結構(應用別)



- 2021年前三季汽車應用產品營收比重持平，但因汽車電子化程度提高，本公司車用電路板營收金額仍比去年同期增加。
- 本公司積極爭取人工智慧與高效運算等高值化產品訂單，2021年前三季相關產品營收比重持續提升。



產品未來發展方向

持續拓展高值化產品

■ 高階ABF載板

2022年除將與客戶緊密合作，持續開發高階電腦、網通、人工智慧及高效運算應用載板外，台灣廠將持續優化先進製程，生產高層數、大尺寸及細線路產品；昆山廠則量產更多成熟產品，藉由成本優勢，爭取更多產品商機，以進一步擴大市佔率。

■ SiP載板

因IC異質晶片封裝發展趨勢不變，系統級封裝(SiP)技術將大量應用在各項行動裝置，本公司將持續增加新世代穿戴裝置、高階5G手機相機、天線模組(AiP)及光學感應器等SiP載板，並切入AR與VR應用，未來SiP載板銷售量將持續增加。

■ 高密度連接板(HDI)

伴隨行動裝置、消費性及車用電子等產品設計愈趨精密，高值化之HDI使用量持續增加，本公司將持續增加高階HDI產品比重，以因應終端電子產品需求成長。



未來營運目標

營運管理方針

- 培養優秀的研發與製程技術人才，再強化研究開發量能，增加產品附加價值。
- 參與客戶設計，共同開發及提供原生數據，分享生產資訊，縮短交期。
- 持續深耕中央處理器、繪圖晶片、高階网通及高效運算等產品，提升高值化與尖端產品銷售比重。
- 持續將人工智慧導入營運管理模式，推動智能化生產，並優化製程條件與設備效能，以軟硬並進的策略，提升良率與效率。
- 本公司將持續擴充高階IC載板產能，依計畫如期完成產能擴建：
 - BT載板擴建：2022年第一季投產
 - 錦興廠ABF載板去瓶頸：2022年第一季投產
 - 樹林廠ABF載板第一期擴建：2023年第一季投產
 - 昆山廠ABF載板第二期擴建：2023年第一季投產
 - 樹林廠ABF載板第二期擴建：2024年第一季投產
- 未來將依市場供需狀況，不排除再規劃新的IC載板產能擴建，使營收持續成長，獲利穩定增加。



感謝您的聆聽

